

科技企业港股上市新机制草案中的知识产权相关规定介绍

作者：王磊 沈骁 王一铎

2022年10月19日，香港交易所(“[港交所](#)”)公告发布[《有关特专科技公司上市制度的咨询文件》](#)(“[《咨询文件》](#)”)。《咨询文件》提出，准备在其《上市规则》中新增设立第18C章节，以降低对于在港交所申请上市的特专科技公司的资格要求，吸引前沿行业来港上市，并就此征询公众意见<sup>[1]</sup>。港交所本次建议设立的新机制，是继2018年在《上市规则》中增设生物科技章节之后对于上市制度的又一重大改革。新机制的设立背景在于，港交所认为其上市制度相较于全球其他市场存在差距，部分未能达到盈利、收益或现金流量等主板资格测试要求的科技企业无法来港上市，转而寻求在科创板等其他市场上市并获得成功<sup>[2]</sup>。本文主要介绍新机制适用的科技行业范围、新机制对申请上市企业提出的科技指标要求和知识产权信息披露要求、新机制落地时间，以便读者点面结合地了解港股新机制中的知识产权相关规定。



新机制适用的科技行业范围

港交所在提议新增的第18C章节中明确，可通过新机制申请上市的“特专科技公司”(Specialist Technology Company)是指“主要于特专科技行业内可接纳领域从事(不论直接或透过其附属公司)研发、商业化及/或销售特专科技产品的公司”<sup>[3]</sup>。

港交所还列明了拟议的特专科技行业的范围<sup>[4]</sup>，并指明其目标即是[涵盖除生物科技以外的创业板行业](#)<sup>[5]</sup>。而生物科技公司此前已可以通过《上市规则》于2018年新增的第18A章规定的机制在港交所上市。

| 科创板行业 <sup>[6]</sup> | 特专科技行业                     | 特专科技具体领域                                                  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 新一代信息技术              | 新一代信息技术                    | 云端服务、人工智能                                                 |
| 高端装备                 | 先进硬件                       | 机器人及自动化、半导体、先进通信技术、电动及自动驾驶汽车、先进运输技术、航天科技、先进制造业、量子计算、元宇宙技术 |
| 新材料                  | 先进材料                       | 合成生物材料、智能玻璃、纳米材料                                          |
| 新能源                  | 新能源及节能环保                   | 新能源生产、新能源储存及传输技术、新绿色技术                                    |
| 节能环保                 |                            |                                                           |
| 生物医药                 | *可适用《上市规则》生物科技章节(即第 18A 章) | *参考《上市规则》生物科技章节(即第 18A 章)                                 |
| -                    | 新食品及农业技术                   | 新食品技术、新农业技术                                               |

可见，《咨询文件》提议的修改如获通过将意味着，[符合科创板上市行业要求的中国内地企业](#)，以后可能也可以[选择在港交所上市](#)。

但是，港交所提议的特专科技行业与科创板也有部分区别[7]。

**首先，港交所提议的新机制比科创板增加了部分行业和领域。**

例如，除前文列示外，港交所在提议的特专科技行业中还新增了“**新食品及农业技术**”行业，并陈明其原因在于“全球正为解决食品安全问题大量开发食品及农业科技，市场对有关技术的需求亦越来越高”[8]。

再如，港交所拟议的特专科技行业中的“先进硬件”行业中还包括“元宇宙技术”领域，而这一领域尚不属于可在科创板上市的范畴。

**其次，部分科创板领域未明确是否亦属于港交所提议的新机制可接纳领域。**

例如，《咨询文件》中，港交所在“先进材料”行业下目前仅明确了“合成生物材料”“智能玻璃”“纳米材料”三项领域属于可接纳领域，尚不能确认其是否进一步包括科创板在“新材料”行业下列明的先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料领域。

**最后，对于某些具体领域所应归属的行业，港交所提议的新机制与科创板存在差异。**

例如，科创板将电动汽车领域归类于“节能环保”行业，将半导体归类于“新一代信息技术”行业，而港交所新机制将其均归类在“先进硬件”行业。

值得注意的是，港交所也在《咨询文件》中明确，当前列示的特专科技行业及其具体领域的范围“并非涵盖所有可接纳行业及领域”，并确认**该范围将在日后持续更新**。



科技相关的指标要求

《咨询文件》建议设立的新机制中，港交所将特专科技公司区分为“已商业化公司”和“未商业化公司”，并对“未商业化公司”在预期市值、营运资金、信息披露等方面提出了更严格的上市要求[9]。

科技相关的指标方面，相较而言，港交所建议设立的**新机制对申请上市公司的研发投入占比的要求较科创板更高**，但港交所并未**设定专利类型与最低数量要求**。

| 科技指标要求            | 科创板   | 特专科技公司 |        |
|-------------------|-------|--------|--------|
|                   |       | 已商业化公司 | 未商业化公司 |
| 最低研发投入占比[9]       | 5%    | 15%    | 50%    |
| 形成主营业务收入的发明专利[10] | 5 项以上 | 无此要求   |        |

港交所在《咨询文件》中特别指出，建议新设的第18C章节不对特专科技公司持有的知识产权的数量和类型提出要求的原因在于，“不同行业注册知识产权的普及情况有所不同”[12]，但港交所仍然认可“特专科技公司的成功通常有赖其拥有的独特技术”[13]，并从知识产权信息披露的角度对特专科技企业提出了具体的要求。



知识产权信息披露要求

---

《咨询文件》建议设立的新机制对于申请上市的特专科技公司提出了详细的信息披露要求<sup>[14]</sup>。

这些应当披露的信息不仅包括常见的商业和经营信息，也包括根据新机制的特点新增的研发风险、知识产权权属等信息。新机制还对未商业化公司的信息披露作出进一步要求。

港交所也明确，“不符合披露要求的上市文件，可能根据《上市规则》不被视作大致完备且可能被退回。”<sup>[15]</sup>

其中，新机制对于知识产权信息的披露要求主要涉及以下方面。

### （一）知识产权的来源

如前所述，新机制并未对申请上市企业持有的知识产权的数量和类型提出要求。

但申请上市企业仍应当对其知识产权作出定性披露，特别是特专科技产品的相关知识产权的来源是“授权引进(in-licensing)”还是“内部开发(internally developed)”<sup>[16]</sup>。

### （二）知识产权覆盖情况、有效期限

新机制要求申请上市企业披露与其特专科技产品相关的知识产权的各项基本信息，包括：

- 披露特专科技产品获得及申请的任何知识产权详情，或适当的否定声明<sup>[17]</sup>；
- 在上市文件的“概要”章节载列重要知识产权<sup>[18]</sup>；
- 重要知识产权应用或保护各特专科技产品的部分(例如应用于主要技术或产品包装上)<sup>[19]</sup>；
- 重要知识产权受保护的程度及形式(例如专利正进行申请程序或已完成注册、用以保障未注册或未进入注册过程的知识产权的程序)<sup>[20]</sup>；
- 重要知识产权的有效期<sup>[21]</sup>。

### （三）知识产权的稳定性

新机制关注申请上市企业与特专科技产品相关的知识产权是否稳定，是否可能因人事问题或合作开发而存在权利变更和纠纷、信息泄露等风险。

具体而言，申请上市企业应当披露以下与知识产权有关的信息：

- 申请人与其主要管理人员及技术人员之间订立的任何服务协议的主要条款<sup>[22]</sup>；
- 申请人为留聘主要管理人员或技术人员而设的措施(例如奖励安排及/或不竞争条款)(如有)，以及针对主要管理人员或技术人员离职而设的措施及安排<sup>[23]</sup>；
- 与重要知识产权相关的重要支付责任<sup>[24]</sup>；
- 如任何重要知识产权牵涉外购许可技术，披露申请上市企业在适用的许可协议中的重大权利及责任<sup>[25]</sup>；
- 如涉及合作研发，披露合作安排的重要条款细则以及将由谁拥有相关知识产权<sup>[26]</sup>。

#### （四）知识产权侵权风险

新机制关注申请上市企业的知识产权侵权风险，并要求企业披露以下内容：

- 说明任何可能会影响任何特专科技产品研发的法律申索或诉讼<sup>[27]</sup>；
- 在上市文件的“概要”及“风险因素”章节中概述任何知识产权侵权的风险，并披露由董事(由保荐人的尽职调查作左证)就申请上市企业是否有侵犯第三方知识产权的正面声明，如是，则披露相关细节以及对申请上市企业经营的潜在影响<sup>[28]</sup>。

#### （五）竞争相关信息

新机制也关注申请上市企业的特专科技产品与同类产品相比的竞争能力，其中包括通过知识产权而形成的竞争态势。

具体而言，申请上市企业应当披露以下知识产权信息：

- 自身特专科技产品的相关知识产权的覆盖市场(jurisdiction，也可译为“权利地域”)<sup>[29]</sup>；
- 已经商业化的或研发中的竞争或潜在竞争产品/服务的核心知识产权的届满日期、技术和目标市场<sup>[30]</sup>。



### 制度落地时间

虽然新机制落地的时间还没有公开，但港交所上市主管此前接受采访时称，在咨询期结束后会“尽快敲定最终版本”<sup>[31]</sup>，并将落实特专科技公司上市安排的时间假设在2023年初<sup>[32]</sup>。

最终版的新上市机制可能与《咨询文件》中的拟议版本存在差异，建议读者届时关注落地的新机制对于特专科技公司上市的实际规定。



### 内容总结和建议

港交所本次建议设立的新机制为更多行业的科技企业提供了上市机会。大致而言，**新机制中可以上市的行业范围将与科创板大致相近。**

此外，相较于科创板，建议设立的新机制进一步将“新食品及农业技术”以及“元宇宙技术”企业纳入可上市的行业范围。

不过，选择新机制上市的科技企业仍需要注意在知识产权信息披露方面符合严格的要求，按要求**披露知识产权的来源、知识产权的覆盖范围和有效期限、知识产权的稳定性、知识产权侵权风险和知识产权竞争**相关信息。有意向的企业为此应尽早做好准备。

1. [https://www.hkex.com.hk/news/regulatory-announcements/2022/2210191news?sc\\_lang=zh-hk](https://www.hkex.com.hk/news/regulatory-announcements/2022/2210191news?sc_lang=zh-hk), 最后访问时间: 2023年1月12日。
2. 《咨询文件》第4-6段。
3. 《咨询文件》附录四《<上市规则>修订拟稿》第18C.01条。
4. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第4段。
5. 《咨询文件》第90段。
6. 《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2021年4月修订)第四条。
7. 关于港交所提议可通过新机制申请上市公司所属的行业和可接纳领域均可参照《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第4段。关于可通过科创板申请上市公司所属的行业和可接纳领域均可参照《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2021年4月修订)第四条。
8. 《咨询文件》第91段
9. 《咨询文件》第109、110段及附录四《<上市规则>修订拟稿》。
10. 参见《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2021年4月修订)第五条、港交所《咨询文件》附录四《<上市规则>修订拟稿》第18C.03(5)(b)条。对于科创板而言,“最低研发投入占比”是指最近三年研发投入占营业收入比例,且最近三年研发投入金额累计在6000万元以上的,通常不需符合最低研发投入占比要求;对于港交所特专科技公司而言,是指上市前三个会计年度每年总研发投入金额占总营运开支百分比。
11. 参见《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2021年4月修订)第六条。对于未达到科创板一般申报指标中任一项要求的申请上市企业,仍可以其“形成核心技术和主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计50项以上”为由申请科创板上市。
12. 《咨询文件》第215段。
13. 《咨询文件》第215段。
14. 根据《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段,特专科技公司上市文件披露的内容包括:首次公开招股前投资的资料、资金消耗率、现金经营成本、产品、披露商业化状况及前景、目标市场、市场份额及行业概览、有关业务模式的披露、研发投入及经验及特定风险、行业标准/主管当局规定、知识产权、风险、上市文件封面的警告声明、未商业化公司的额外披露。
15. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第30段。
16. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(d)(iv)项。
17. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(i)项。
18. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(ii)项。
19. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(iii)项。
20. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(iii)项。
21. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(ii)项。
22. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(h)(v)(5)项。
23. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(h)(v)(6)项。
24. 《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(ii)项。

25.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(ii)项。

26.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(h)(v)(3)项。

27.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(h)(v)(7)项。

28.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(j)(iv)项。

29.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(d)(iv)项。

30.《咨询文件》附录五《指引信拟稿》第32段第(f)(ii)项。

31. [https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_20367853](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20367853)，最后访问时间：2023年1月12日。

32. <http://www.aastock.com/sc/stocks/news/aafn-con/NOW.1234459/company-news/HK6>，最后访问时间：2023年1月12日。

2023-01-16